

Mit Lichtgeschwindigkeit zur perfekten Siebdruckschablone!

Mit diesem Anspruch entwickeln und produzieren wir in der Schweiz eine umfangreiche Palette von **Computer-to-Screen (CtS) Anlagen** unter dem Logo **SWISS CtS TECHNOLOGY**. Die TEC-Serie ist bereits die **vierte Generation** von StencilMaster Direktbelichtungsanlagen.

STM-TEC_XS mit einer maximalen Siebrahmengrösse von H 1200 x W 900 mm

STM-TEC_S mit einer maximalen Siebrahmengrösse von H 1200 x W 1250 mm

Die konventionelle Siebelichtung ist durch die grosse Anzahl von Prozessschritten sehr aufwändig, teuer und fehleranfällig. Die CtS Anlagen setzen neue Massstäbe und überzeugen mit diesen Vorteilen:
Höchste Reproduzierbarkeit dank **DIGITAL SCREEN MAKING**, Filmkosten und Handling entfallen, Verbesserung der Druckqualität, höhere Produktivität, grosse Flexibilität und tiefere Schablonenkosten.

UV-Lichtquelle: Leistungsstarke **LED_Q4 (Gen6)** oder **330W CPL UV-Lampe** für eine optimale Belichtung und Durchhärtung mit nahezu allen Direktemulsionen und auf allen Geweben. Als Variante kann auch eine **UV-LED DUO Lichtquelle** angeboten werden.

Optik von ZEISS: lichtstark, verzugsfrei, stabil und hoch präzise.

Verfügbare Auflösung: 1270 dpi, 1609 dpi (HR1), 2400 dpi (HR2), 3040 dpi (HR3).

OECU (Optical Engine Control Unit): Das Herzstück der neuen Generation. Diese Eigenentwicklung verbindet als Steuereinheit alle Prozesse für den Belichtungskopf. **DMD's (Digital Micromirror Device)** der neusten Generation werden ebenso angesteuert wie die hoch präzisen Horizontal- und Fokusachsen.

STPrint V.4: Die Bedienersoftware aus eigenem Haus erlaubt die zentrale Bedienung und Steuerung der STM Anlagen – inkl. ganzer IN-LINE Anlagen.

Grundkonstruktion: Diese Bauweise aus hochwertigem und massivem Stahl ist unerlässlich für eine hochwertige und präzise Direktbelichtung. Auf der Grundkonstruktion wird das Mehrachsensystem aufgebaut. Eine luftgelagerte Belichtungseinheit sorgt für vibrationsfreie Bewegungen und das einzigartige Antriebssystem arbeitet in horizontaler Richtung.

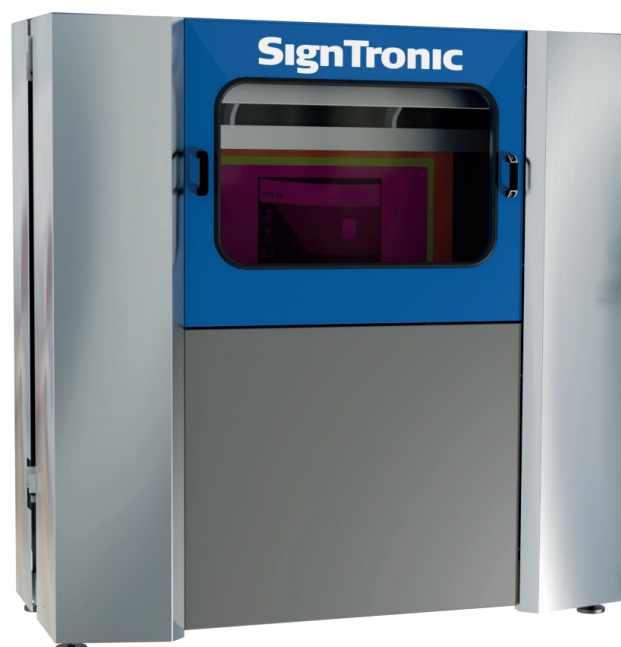
Bidirektionale Belichtung: Diese Standard-Arbeitsweise ist durch die Vor- und Rückwärtsbewegung sehr präzise und schnell.

Automatische Positionierung der Siebrahmen: Alle StencilMaster der TEC-Series können von beiden Seiten be- und entladen werden. Der automatische Einzug sorgt für einfaches Handling, schnelle und genaue Positionierung als auch Fixierung in der Anlage.

Modular ausbaubar: Anlagenkonzept mit Anbindung aller Grünig IN-LINE Anlagen (Lade- und Entlademagazine, Entwicklungs-, Beschichtungs-, Abblas- und Trocknungsanlagen) möglich.

Option RICB (Remote Image Control Board):

Damit wird die Belichtungsqualität einfach überwacht und beibehalten. U.a. sind folgende Kontrollen und Messungen möglich: mechanische Grundeinstellung inklusive Fokussmessung, Lichtmessung des gesamten DMD.



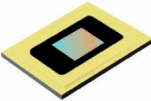
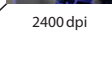
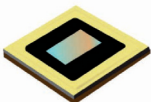
STM
TEC

StencilMaster[®]

Technische Spezifikationen

Technische Daten	STM-TEC_XS	STM-TEC_S
Höhe	2035 mm	2035 mm
Breite	2000 mm	2400 mm
Tiefe	985 mm	985 mm
Netto Gewicht	ca. 1250 kg	ca. 1350 kg
Max. Rahmenformat (H x B)	1200 x 900 mm	1200 x 1250 mm
Max. Belichtungsformat (H x B)	1050 x 740 mm	1050 x 1040 mm
Verfügbare Auflösung	1270 dpi, 1609 dpi (HR1), 2400 dpi (HR2) oder 3040 dpi (HR3)	
UV-Lichtquelle	LED_Q4 (Gen6), High power CPL 330 W oder UV-LED DUO (385 nm / 405 nm)	
Leistungsaufnahme	~ 1100 W	
Datenschnittstelle	Ethernet 1-Gbit	
Fernwartung	In Datenschnittstelle integriert (Internetverbindung notwendig)	
Betriebssystem	Windows 11	
Technische Anforderungen		
Spannungsversorgung	208-240 VAC / 50 Hz / 16A	
Druckluftanschluss	6 bar	
Druckluftverbrauch	max. 50 l/min	
Druckluftqualität	ISO 8573-1 4.4.4	
Raumbedingungen	Gelblicht, staubfrei, vibrationsfreier Boden	
Bodenbelastung	500 kg/m2	
Umgebungstemperatur	18 - 24° C	
Luftfeuchtigkeit	25 - 75 % (rF)	
Benötigtes Datenformat	1-bit TIFF	
Optionen		
Prozesskontrolle	RICB (Remote Image Control Board)	
Masterframe M	Aufnahme für mehrere kleine Siebrahmen	
Auflösung	1609 dpi (HR1), 2400 dpi (HR2), 3040 dpi (HR3)	
RIP Software	SignTronic ST.Rip	
Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGB der Grünig-SignTronic AG		

MODULAR Cts CONCEPT

	UV-Lichtquelle	Technologie DMD	Zeiss Optik /Auflösung
UV-LED	Q4 365 / 385 / 395 / 405 nm 	XGA 0.7"– Discovery 4100 	1270 dpi 
	DUO 385 nm / 405 nm 		2400 dpi 
UV-Lampe	CPL 350 – 450 nm 	1080p 0.95"– Discovery 4100 	1609 dpi 
	UHP 350 – 450 nm 		3040 dpi 